

供給確保計画の概要

1. 変更認定の日付

令和7年12月26日

2. 供給確保計画の認定番号

2023半導体第4号—2

3. 供給確保事業者の名称等

株式会社レゾナック

株式会社レゾナック・ハードディスク

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体部素材（SiC ウエハ）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
SiC ウエハの国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：小山市（栃木県）、東根市（山形県）、市原市（千葉県）
 - ・主要製品：SiC ウエハ（基板・エピタキシャル）

	生産場所	供給開始	生産能力
SiC ウエハ (基板)	小山市	2028年6月	11.7万枚/年（6インチ換算）
	東根市		
SiC エピウエハ (エピタキシャル)	市原市	2028年7月	28.8万枚/年（6インチ換算）
	東根市		

（※）供給開始の日から10年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額：309億円（最大助成額：103億円）
- 希望する支援措置
助成金交付